

今こそ 2024 年 12 月の SME 規制強化の復習を

米満 啓

1. 総論

あくまでも私の感覚ですが、輸出管理に精通した人でも、表題の規制強化を詳しく覚えていないことが結構多いような気がします。例えば次のような…

当初こそ「一段と強化した対中半導体関連規制」と身構えたものの、ややこしそうな内容だし各種解説を読んでもわかった気がしない。困っていたら、どうも「日本（を含む 33 か国）は規制免除」らしい。ということで（どんな「免除規定」かまで知らんが）ホッと一息、あとは忘れた。

それから 1 年余りが過ぎ、米国下院で審議中の MATCH 法案が注目を集めています。この法案が成立すると「日本（を含む同盟国）は 150 日以内に米国の求める対中規制を行わないと米国からトンドモナイ仕打ちを受ける」らしい、とされています。

「トンドモナイ仕打ち」の内容について、日経は「米国の同盟国にも同等の厳格化を求め、150 日以内に対応がなければその国の輸出する装置に米国独自の規制をかける」と述べています。（<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1607MOW6A410C2000000/>）

「日本に 150 日以内の同水準規制を要求し、未実施なら米国が単独で全面禁輸を発動可能な内容」という解説（<https://timewell.jp/columns/semiconductor-export-control-japan-us-2026>）もあります。

読み手としては思わず浮足立ってしまいそうですが、**その前にやっておくべきことがあります。それが 2024 年 12 月の規制強化の復習です。**理由を 3 つ挙げます。

第 1 は 2024 年の措置にも「諸外国が米国の規制に協力してくれることへの期待」が打ち出されていたことです。前述の「33 か国規制免除」も「それらの国が米国に協力的」という認識を前提するものでした。仮に例えば日本政府の対米協力を不満があるならば、この規制免除を停止することから始めるのがスジというものでしょう。

第 2 に 2024 年 12 月の措置自体が、（免除対象 33 か国以外には）「かなりトンドモナイ内容」でした。そのまま実行するだけで、相当なインパクトがあるのです。

第 3 に、今回の法案が同盟国に求めているのは「米国並みの規制実施」です。言い換えると「EAR 対象品に対する米国法令の規制をしてくれ」です。また、そのための協力が不十分な国に対しては、その国からの輸出品に「jurisdiction を確立する」と言っていますが、これはおそらく「EAR 対象品として扱うぞ」を意味するのでしょうか。明らかに **2024 年 12 月のメッセージ（同盟国製品を EAR 対象に認定し、米国政府が規制する）を、「EAR 対象認定はしないが、米国政府の代わりに自分で規制してくれ」にスライドさせたのが MATCH 法案**ということです。つまり両者はかなり近い存在なのです。

となれば、もう一度元気を出して、2024 年 12 月規制の中身を勉強し直さなければなりませんよね。

2. 2024年12月規制の四本柱

このときの規制強化の主軸となったのが、次の4ルールです。(世間ではこの4つをを詳しくかつ別々に解説したテキストが多いのですが、中々頭に入りにくいので、ここでは私がサワリと考える部分のみ記しました)

4つのルール	あらまし
§ 734.4(a)(8)・本稿では「デミニミス a8 ルール」と呼ぶ	<u>澳門・D5 国向け案件のカテゴリ 3～5 部品デミニミス不適用ルール。</u> 輸出品が機微*1な SME の場合に適用される。
§ 734.4(a)(9)・本稿では「デミニミス a9 ルール」と呼ぶ	<u>中国の Entity List 脚注 5 ユーザー向け案件のカテゴリ 3～5 品デミニミス不適用ルール。</u> 輸出品があまり機微でない*2 SME の場合に適用される。 (「機微」な品目は上記 a8 ルールの対象)
§ 734.9(e)(3)・一般には「FN5-FDP ルール」、 但し本稿では「FDP-e3 ルール」と呼ぶ	<u>中国の Entity List 脚注 5 ユーザー向け FDP ルール。</u> 輸出品があまり機微でない SME*3 の場合に適用される。 (「機微」な品目はルールの下記 k ルールの対象) 特に要注目は (B)(2) パターンで、「SME 関連 12 種 ECCN*4 の米国産技術/ソフトの直接製品に当たるプラント/設備により作られた IC を内蔵」のケース (1 個でも内蔵なら該当)
§ 734.9(k)・一般には「SME-FDP ルール」、 但し本稿では「FDP-k ルール」と呼ぶ	<u>澳門・D5 国向けで、ECCN が機微な非米国産品についての FDP ルール。</u> 特に要注目は (ii)(B) パターンで「SME 関連 12 種 ECCN*4 の米国産技術/ソフトの直接製品に当たるプラント/設備により作られた IC を搭載」のケース ((1 個でも内蔵なら該当) が挙げられている。

*1 の「機微な」; 3B001 のうち、細目 a.4, c, d, f.1, f.5, k to n, p.2, p.4, r,
3B002 のうち、細目 c の品目

*2 の「機微でない」; 3B001 と 3B002 のうち、上記*1 外の 3B001/3B002 の品目

*3 の「機微でない」; *2 の ECCN + 3B992, 3B993, 3B994 の品目

*4 の「12 種 ECCN」; 3D001 (for 3B 品)、3D901、3D991 (for 3B991 品/3B992 品)、
3D992、3D993、3D994、
3E001 (for 3B 品)、3E901 (for 3B903 品)、
3E991 (for 3B991/3B992 品)、3E992、3E993, or 3E994

私などは上表の書き方でも、まだ困難を覚えることがあります。そこで更に端折って示します

規制手法	案件の性質	
	D5 国/澳門の全ユーザー向け かつ 機微なスペック	脚注 5 の中国 16 ユーザー向け かつ 機微でないスペック
デミニミス不適用	デミニミス a8 ルール	デミニミス a9 ルール
FDP	FDP-k ルール	FDP-e3 ルール

3. 2024年12月規制はどこがトンデモナイのか

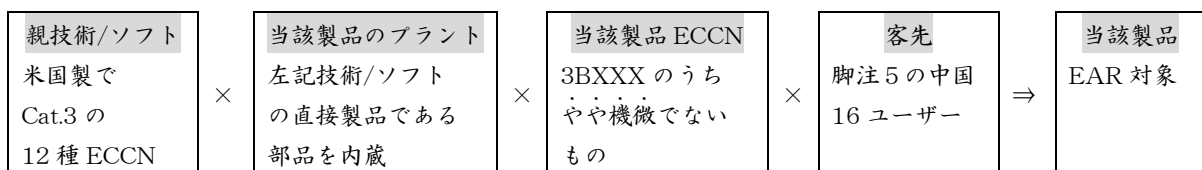
それは、前頁で「特に要注目」と述べた次の2規定です。

3-1 FDP-e3 ルールの「要注目」規定・(B)(2)パターン

(B)(2) 米国外に所在するプラント全体若しくはプラントの'主要な構成装置' (そのプラント全体若しくはプラントの'主要な構成装置' (米国内で製造されたか米国以外で製造されたかを問わない) 自体が、米国原産の"技術"又は"ソフトウェア"であって、CCL の ECCN 3D001 (3B の貨物のためのもの)、3D901、3D991 (3B991 及び 3B992 のためのもの)、3D992、3D993、3D994、3E001 (3B の貨物に係るもの)、3E901 (3B903 に係るもの)、3E991 (3B991 及び 3B992 に係るもの)、3E992、3E993、若しくは 3E994 に指定されるものの"直接製品"である場合に限る) により製造された貨物を含む場合。

(e)(3)(i)(B)(2)項の注3：米国外で製造された貨物がプラント全体若しくはプラントの'主要な構成装置' (そのプラント全体若しくはプラントの'主要な構成装置'自体が (e)(3)(i)(B)(2)項で規定される ECCN で指定される米国原産の"技術"又は"ソフトウェア"の直接製品である場合に限る) により製造された集積回路を含む場合、(e)(3)(i)項の製品の適用範囲にある。(訳は EAR 研究者鈴木さんによる)

長いセンテンスなので分解して読むと、こんな風になります。



注目点は式の第2項「左記技術/ソフトの直接製品である部品を内蔵」です。2つ問題があります。

【問題点1】 当該SMEを作ったプラントの内蔵部品の詳細情報なんてわかるのか？

きちんとやろうと思ったら、何を調べねばならないか。敢えてくどく書くと…

- ・そのSMEを作ったプラントの内蔵部品をリストアップ
- ・各部品について「米国製の12種ECCN技術/ソフト」から生まれたかを確認

常識的に言って、そこまでやるのはまず無理でしょうね。

要するに、もし「e3ルール大丈夫か？」と詰め寄せられたら潔白を証明するのは極めて困難なのです。

もちろんクロを証明するのも同様に困難ですから「やれるもんならやってみな」と開き直る道もあるでしょう。しかし(本稿を読んで下さるような)遵法精神旺盛な日本企業が、その道を選ぶことはないと思います。とすれば、**脚注5の中国16ユーザー向けSMEは、最初からギブアップ**という選択になるのではないのでしょうか？

そして、まさにこの理由により、**FDP-e3ルールの中で、(B)(2)パターンこそが最も殺傷力に富み、最も注目に値する**のではないかと思います。

【問題点2】 こんな規制論理があるのか？

そもそも FDP ルールの考え方は、海外品であっても「米国技術／ソフトから生まれた」ものなら「米国品みたいなもの」だから規制する、というものでした。(§734.3(a)(4)) 本節で扱っている「米国技術／ソフトから生まれたプラントで…」は、そこから派生した§734.3の(a)(5)型規制です。いずれにしても「米国技術／ソフトの子孫である海外品」を「米国品に準ずる」として規制対象にするわけです。

話を FDP-e3 ルールに戻しましょう。このルールで外国製 FDP が EAR 対象とされる論理は次のような命題の連鎖から構成される筈です。

- ・「12種 ECCN の米国技術／ソフトから生まれた」部品を「米国品に準ずる」と見なす。
- ・「米国品に準ずる」部品を内蔵したプラントも「米国品に準ずる」ものと見なす。
- ・「米国品に準ずる」プラントで作られた SME だから「米国品に準ずる」と見なす。

ところがここに問題があります。

「12種 ECCN の米国技術／ソフトから生まれた」部品なら即 EAR 対象でしょうか？ また「米国品に準ずる」部品を内蔵したプラントなら即 EAR 対象でしょうか？

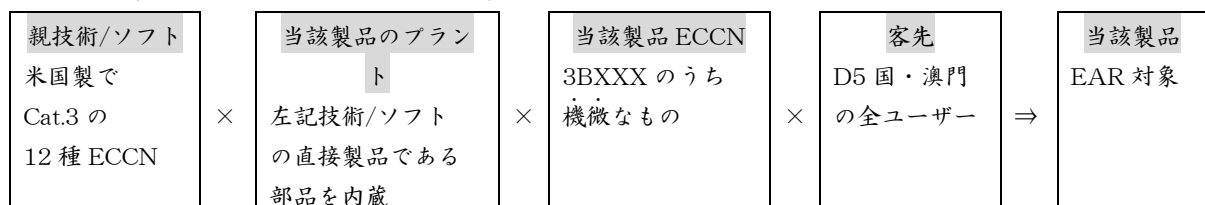
私の理解では、どちらもノーです。「論理が通っていない」規制だというのはそれゆえです。

3-2 FDP-k ルールの「要注目」規定・(ii)(B)パターン

(ii)(B) 米国外に所在するプラント全体若しくはプラントの'主要な構成装置'(そのプラント全体若しくはプラントの'主要な構成装置'(米国内で製造されたか米国以外で製造されたかを問わない)自体が、米国原産の"技術"又は"ソフトウェア"であって、CCL の ECCN 3D001 (3B の貨物のためのも)、3D901、3D991 (3B991 及び 3B992 のためのも)、3D992、3D993、3D994、3E001 (3B の貨物に係るもの)、3E901 (3B903 に係るもの)、3E991 (3B991 及び 3B992 に係るもの)、3E992、3E993、若しくは 3E994 に指定されるものの"直接製品"である場合に限る)により製造された貨物を含む場合。

(k)(1)(ii)(B)項の注3: 米国外で製造された貨物がプラント全体若しくはプラントの'主要な構成装置'(そのプラント全体若しくはプラントの'主要な構成装置'自体が(k)(1)(ii)(B)項で規定される ECCN で指定される米国原産の"技術"又は"ソフトウェア"の直接製品である場合に限る)により製造された集積回路を含む場合、(k)(1)項の製品の適用範囲にある。(k)(1)項の適用範囲に関する追加ガイダンスについて、§732 の付則3のレッドフラッグを参照のこと。集積回路の製造には、ウェハー内での集積回路の製造、並びに集積回路の組立、試験、及び梱包が含まれる。(訳は EAR 研究家鈴木さんによる)

これも分解して読むことにしましょう。



同じく、注目点は式の第2項「左記技術/ソフトの直接製品である部品を内蔵」です。3-1 で述べた2つの問題点がここにもあります。

4. 2つのデミニミス不適用ルール (a8ルールとa9ルール) をどう見るか

巷の参考書でそれらは、FDPのe3ルール・kルールと切り離して解説されることが多いように思います。その結果、次のようなフラストレーションが溜まった読者も多いのではないのでしょうか？

- ・勉強しなければならないルールが増えてうんざり
- ・この2ルールでも、輸出品のECCNに前述FDPルールとそっくりな記述がある
- ・それらFDPルールでも「12種ECCN部品が1個でも内蔵なら」の機銃tがあった
(「デミニミス不適用」というのはどちらの規定の話なのか?)

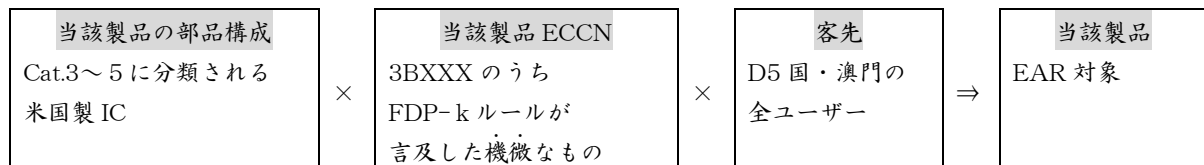
実は(御推察の通り) a8とa9のデミニミス不適用ルールは、e3とkのFDPルールとつながり(補完関係)があります。まずは2つのデミニミス不適用ルールの内容を見ておくことにしましょう。

4-1 デミニミス a8ルール

§ 734.4(a)(8) EAR § 774 付則 1 の商務省規制品リスト(CCL)の ECCN 3B001.a.4、c、d、f.1、f.5、f.6、k から n、p.2、p.4、r、又は 3B002.c のパラメータを満たす貨物について、その貨物が CCL のカテゴリー 3、4、又は 5 で指定される米国原産の集積回路を含み、かつ、マカオ又は D:5 国を仕向地とする場合、SME の FDP ルールに関連するデミニマスレベルはない (ただし、EAR § 742.4(a)(4)の国家安全保障輸出許可要件又は § 742.6(a)(6)の地域安定輸出許可要件から除外される場合を除く)。

(訳はEAR 研究家鈴木さんによる)

分解して読むことにしましょう。



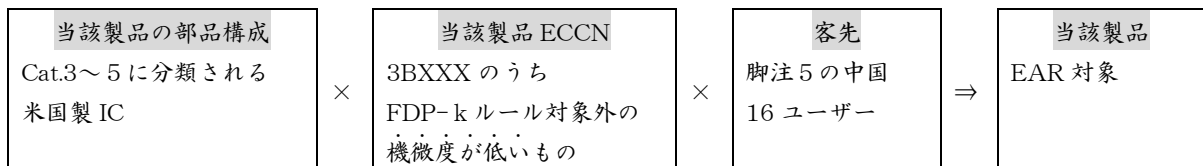
「SME の FDP ルールに関連するデミニマスレベル」という表現がイヤラシイですね。

そう言われると「SME の FDP ルールに関連しないデミニマスレベル」って何だろう、と思ってしまいますから。ここは「デミニミスは認めない」、その意図は「SME—FDP 規制の趣旨による」と理解しておこうと思います。「SME—FDP 規制の趣旨」とは、D5 国・澳門向けは機微な SME を EAR 対象品として規制するぞ、ということでしょう。

4-2 デミニミス a9 ルール

§ 734.4(a)(9) 脚注 5 の FDP ルールに関連する品目について、EAR § 774 付則 1 の商務省規制品リスト(CCL)のカテゴリ-3B (3B001.a.4、 c、 d、 f.1、 f.5、 f.6、 k~n、 p.2、 p.4、 r、 又は 3B002.c を除く) に指定される ECCN のパラメータを満たす品目に対しては、その貨物が CCL のカテゴリ-3、4、又は5に指定される米国原産の集積回路を含み、かつ、その貨物が EAR § 744 の付則 4 のエンティティリストの輸出許可要件の欄で脚注 5 が付された事業者に向けられる場合、或いは当該貨物がロジック又は DRAM の“先端プロセスノード IC”の“製造”に使用されるという“認識”がある場合においてマカオ又は D:5 国に所在する最終需要者の“施設”に向けられる場合、脚注 5 の FDP ルールに関連するデミニマスレベルはない。(訳は EAR 研究家鈴木さんによる)

分解して読むことにしましょう。



「脚注 5 の FDP ルールに関連する品目について」は、a8 ルールの下線部に似ていますが文字通りに読めばよいでしょう。つまりは、**脚注 5 の中国 16 ユーザー向けの低機微度 SME は米国産の Cat.3~5 に分類される IC が 1 個でも使われていたら、即 EAR 対象品として規制する**ということです。

次節では以上の理解を踏まえて、新しい FDP ルールとの関係を考えることにします。

5. デミニミス不適用とFDPルールとの関係

誰でも感ずるのは、**デミニミス不適用とFDPルールの類似性・紛らわしさ**です。

少なくとも米国規制を勉強する立場としては、(前述の如く)「余計な(ややこしい)ことをしてくれた」と言いたくなるどころです。なぜこんなことをしたのかに言及している解説を私は見たことがありませんが、おそらく**次のような「棲み分け」があるもの**と思います。

ルールの種類	米国規制による海外製品の紐づけ・結節点
デミニミス不適用 (a8・a9ルール)	当該SMEに於ける米国製のICの使用
FDP (e3・kルール)	当該SMEに使用されているとも、またそれが米国製とも限らないが、米国技術／ソフト由来のICが当該SMEの製造プラントに使用

では**なぜわざわざルールを、デミニミス不適用とFDPの2つも作った**のでしょうか？ もちろん片方だけでは足りないという認識からでしょうが、だとすれば**先に着想されたのはどちら**なのでしょう？

私の考えを言います。おそらく**先に着想されたのはデミニミス不適用ルール**の筈です。理由を2つ挙げます。

第1の理由は、製造プラントに於ける使用ICが**米国技術／ソフト由来**だから、というFDP流の不自然さです。あまりにもクネクネと遠回しな論理ぶりと思いませんか？ 普通、人はこんなのを最初から狙って作りません。

第2に、「1個でも米国製部品が内蔵されていたら」という考え方には前例があります。2023年11月導入のArF液浸リソグラフィ装置へのデミニミス不適用のルールです・§734.4(a)(3) CISTECは次のように解説しています。

○なお、日蘭が規制対象としたArF液浸露光装置については、規制パラメータに若干の差があったが(蘭の方が狭い)、今回の米国の規制では、**デミニミスルールの適用について異例の措置が取られ、蘭が対象外とした(日本では対象)パラメータの装置が米国再輸出規制の対象とされることになった**。即ち、先端ICの開発又は製造に利用される再輸出の場合、**デミニミスルールの適用はなく、わずかに組み込まれているだけで、原則として、EAR対象になる**。<https://www.cistec.or.jp/service/uschina/20231124.pdf>

今回、BISはこの手口を応用したのでしょうか。但し、**米国製でないIC使用のケースも網に掛けた**い、**そこで知恵を絞って新たなFDPルールを捻り出した**のだと思います。その意味では新FDPルールでは、本稿が「特に要注目」とした「**米国技術／ソフト由来部品使用のプラントで製造のSME**」規定だけあれば十分だった筈です。(e3ルールで言えば(B)(2)パターン、kルールで言えば(ii)(B)パターン) 新FDPルールにはこれら以外のEAR対象認定パターンの記述もありますが、極言するならそれらはダミーに過ぎないという理屈になります。BISは2024年12月5日付けIFRのタイトルを「Foreign-Produced Direct Product Rule Additions,…」としてますが、そのタイトルもダミーっぽい、と私は感じてします。

とりあえず私は、本稿の理解をベースにMATCH法案を見ていこうと思っています。